

超低热阻导热硅脂

TG300-LR是一款具有超低热阻系数的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料，耐热性、长效性、可靠性佳，同时其极低的BLT厚度可以有效减少散热器及发热源之间的接触热阻，适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和高界面热管理能力需求的应用场合。



特性和优点

- 导热系数3.0W/(m·K)
- 不含金属填料颗粒，高绝缘
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻

典型应用

- IT-笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 网络通讯装备—无线模块、路由器
- 消费类电子—游戏系统、便携设备
- 工业工控设备
- 电源
- 高功率LED照明

| 典型属性                                 |                  |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 属性                                   | 典型值              | 测试方法           |
| 颜色                                   | 白色               | 目视             |
| 密度(g/cc)                             | 3.2              | ASTM D792      |
| BLT(μm)                              | 5                | 千分尺            |
| 挥发份(%)                               | ≤0.5             | @125°C/48h     |
| 粘度(cP)                               | 340000           | DV2T-T96-12RPM |
| 锥入度(0.1mm@25°C)                      | 326              | GB/T269        |
| 耐温范围(°C)                             | -40~150          | /              |
| 保质期(月)                               | 12               | 温度<40°C避免挤压、暴晒 |
| 电性能                                  |                  |                |
| 击穿电压(kV/mm)                          | ≥5.0             | ASTM D149      |
| 体积电阻率(Ω·cm)                          | 10 <sup>10</sup> | ASTM D257      |
| 导热性能                                 |                  |                |
| 导热系数(W/(m·K))                        | 3.0              | ISO 22007-2    |
| 热阻(°C·in <sup>2</sup> /W@50psi,80°C) | ≤0.006           | ASTM D5470     |